



HYCOL TS5

ROZPUSZCZALNIKOWY KLEJ DO PARKIETU

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy, bezwodny, niezawierający metanolu, szybko wiążący klej na bazie żywic syntetycznych o doskonałej przyczepności i wysokiej wytrzymałości, przeznaczony do klejenia posadzek drewnianych według DIN 281. Do przyklejania parkietu, mozaiki parkietowej, parkietu lamelowego, mozaiki sztorcowej (przemysłowej), mozaiki tradycyjnej i pałacowej oraz parkietu taflowego z krajowego drewna na podkładach cementowych, anhydrytowych, z lanego asfaltu oraz na podłożach drewnianych po przeszlifowaniu. Nie nadaje się do parkietu masywnego o grubości 10 mm. Do przyklejania lakierowanego fabrycznie parkietu litego i desek polecamy stosować Legnopol 2000 lub SMP BOND. Do stosowania wewnątrz.

Przystosowany do użycia pod meble na kółkach (EN 12529) oraz na ogrzewaniu podłogowym.

- Wysoka wytrzymałość na ścinanie
- Szybko wiążący
- Szeroki zakres stosowania
- Wysoka wytrzymałość końcowa
- Bardzo łatwy do rozprowadzania
- Bardzo ładny odlew zęba

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Baza surowcowa:	Żywiec syntetyczne, zawiera rozpuszczalniki
Ciężar właściwy:	1,55 Gramm/cm ³
Zawartość ciał stałych:	82%
Nakładanie:	szpachla zębata TKB B 5 – B 11.
Zużycie:	ok. 700 – 1000g/m ² w zależności od użytej szpachli zębatej i podłoża.
Czas odparowania:	brak
Czas klejenia:	ok. 10 minut w zależności od nałożonej ilości w normalnych warunkach.
Czas do użytkowania posadzki:	ok. 24 do 72 godzin.
Temperatura użycia:	powyżej +10°C
Składowanie:	powyżej +5°C, Wrażliwy na mróz.
Okres przydatności do użycia:	ok. 24 miesiące w oryginalnych opakowaniach w temperaturze pokojowej.

WOOD-TECH s.c.

ul. Jagiellońska 78 lok. 3.19, 03-301 Warszawa
mail: omika@wood-tech.pl, biuro@wood-tech.pl
mobile: 00 48 791 676 163, office : 00 48 533 717 553



Wskazówki dot. zagrożeń:	Łatwopalny: Nie wdychać oparów. Podczas pracy z produktem, a po jej zakończeniu należy intensywnie wietrzyć pomieszczenia.
Giscode:	S1
Opakowanie:	Wiadro metalowe
Wielkość opakowania:	20 kg – 44 opakowania na palecie

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich warunków technicznych wykonania robót (np. DIN 18365 wzgl. 18352 i Onorm B2218 wzgl. B2236-1). Podłoże musi być twarde, nośne, suche, bez spękań, czyste, bez pozostałości starych klejów i innych substancji obniżających przyczepność kleju. Z jastrychów cementowych usunąć odpowiednimi maszynami warstwę mleczka cementowego. Przed klejeniem parkietu należy zagruntować jastrych gruntem Primer VS i poczekać jak grunt wyschnie. Jastrychy anhydrytowe przed klejeniem przeszlifować (ziarno 16) w celu usunięcia warstwy mleczka anhydrytowego (zgorzeli), odkurzyć i zagruntować. Podkłady z ogrzewaniem podłogowym należy z reguły zagruntować środkiem Primer VS. Na podkładach alfaltowych odradzamy układanie parkietu. Nierówności podłoża należy wyrównać przynajmniej 3 mm warstwą masy wzmacnianej włóknem Fibrodur lub mocnej masy Levelfast.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem należy zamieszać klej, a następnie nakładać równomiernie na podłoże odpowiednią szpachlę zębatą. W celu uzyskania przyklejenia parkietu na całej powierzchni należy stosować szpachle o odpowiednim rozmiarze zęba. Klej nakładać na takiej powierzchni, na jakiej można ułożyć parkiet w czasie 10 minut. Deszczułki układać natychmiast, lekko przesunąć i docisnąć. Zwracać uwagę na możliwie pełne pokrycie klejem spodniej strony deszczułek. Pomiedzy ścianami, a parkietem zachować odstęp o szerokości 10-15 mm. Unikać sklejanie deszczułek ze sobą. Świeże pozostałości kleju można usuwać przy pomocy Cleancoll. Narzędzia należy czyścić Solvente CH 500 (zapoznaj się z odpowiednimi kartami technicznymi produktów).

UWAGI: Podane czasy odnoszą się do normalnych warunków (ok. +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza). Optymalne warunki stosowania: +10 do +25°C, temperatura podłoża powyżej +15°C i względna wilgotność powietrza poniżej 75%, zalecane <65%. Niskie temperatury wydłużają, a wysokie skracają czas układania, wiązania i schnięcia a także czas do użytkowania posadzki. Rozpoczęte opakowania starannie zamykać a pozostałą zawartość zużyć niezwłocznie. Zimą należy klej odpowiednio długo klimatyzować w pomieszczeniu, żeby uzyskał temperaturę pokojową. Obok poniższej karty należy uwzględnić zalecenia producenta posadzki i karty techniczne ww. produktów. Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku

WOOD-TECH s.c.

ul. Jagiellońska 78 lok. 3.19, 03-301 Warszawa
mail: omika@wood-tech.pl, biuro@wood-tech.pl
mobile: 00 48 791 676 163, office : 00 48 533 717 553



WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA: Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. W czasie stosowania przestrzegać obowiązujących norm i przepisów BHP. Klasa niebezpieczeństwa B według VbF oznakowanie F. P. Unikać kontaktu z płynnym produktem oraz wdychania oparów rozpuszczalników. Produkt i jego opary są łatwopalne. Nie palić, unikać otwartego ognia. Podczas pracy z produktem, a także po jej zakończeniu należy intensywnie wietrzyć pomieszczenia. W celu uniknięcia pojawienia się iskry elektrycznej odłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, przełączniki itp.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI: Opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Podane informacje odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju. Nie należy traktować ich jako wiążących, ponieważ nie mamy wpływu na sam montaż a wymogi montażu również są zróżnicowane. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Dotyczy to również bezpłatnego, nie wiążącego doradztwa handlowego i technicznego. Z tego powodu zalecamy przeprowadzanie prób we własnym zakresie w celu stwierdzenia, czy dany produkt jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania. W momencie ukazania się niniejszej karty wszystkie wcześniejsze informacje techniczne dotyczące produktu tracą ważność.

NINIEJSZA KARTA TECHNICZNA ZASTĘPUJE WCZEŚNIEJSZĄ.

WOOD-TECH s.c.

ul. Jagiellońska 78 lok. 3.19, 03-301 Warszawa
mail: omika@wood-tech.pl, biuro@wood-tech.pl
mobile: 00 48 791 676 163, office : 00 48 533 717 553